Deutsches
Patent- und Markenamt

Registerauszug
zum
Aktenzeichen 101 56 465.1

Stand am 20.05.2024
(letzte Aktualisierung in DPMAregister am 07.01.2024)

Es bestehen folgende Eintragungen:

Stammdaten

[-----] **Schutzrechtsart:** Patent

[-----] **Status:** Nicht anhängig/erloschen

[21] **Aktenzeichen DE:** 101 56 465.1

[54] **Bezeichnung/Titel:** Waferanordnung und Verfahren zur Herstellung einer Bondverbindung

[51] **IPC-Hauptklasse:** H01L 21/58 (2006.01)

[22] **Anmeldetag DE:** 16.11.2001

[43] **Offenlegungstag:** 10.07.2003

[-----] **Veröffentlichungstag der Erteilung:** 10.07.2003

[71/73] **Anmelder/Inhaber:** Infineon Technologies AG, 81669 München, DE

[-----] **Erfinder:** Rüb, Michael, Dr., Faak, AT; Pairitsch, Herbert, Klagenfurt, AT;

[10] **Veröffentlichte DE-Dokumente:** DE000010156465C1

[-----] **Zustellanschrift:** Infineon Technologies AG Intellectual Property, 80506 München, DE

[-----] **Zuständige Patentabteilung:** 36

[57] **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft eine hochtemperaturstabile, wiederablösbare Waferanordnung mit einem ersten Wafer, in dessen erste Oberfläche erste Ausnehmungen und in dessen zweite Oberfläche zweite Ausnehmungen eingebracht sind, die jeweils zumindest teilweise Teil von durchgehenden Verbindungen zwischen der ersten und zweiten Oberfläche des ersten Wafers sind, mit einem zweiten Wafer, mit einer temperaturstabilen, wiederablösbaren Bondverbindung, die mindestens eine zwischen dem ersten und dem zweiten Wafer angeordnete und diese voneinander beabstandende Schicht, insbesondere dielektrische Schicht, aufweist und die die erste Oberfläche des ersten Wafers mit einer ersten Oberfläche des zweiten Wafers durch Waferbonding verbindet. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Bondverbindung.

[56] **Entgegenhaltungen/Zitate:** DE000010029035C1 (DE 100 29 035 C1); DE000019842419A1 (DE 198 42 419 A1); DE000010047963A1 (DE 100 47 963 A1); DE000010029791A1 (DE 100 29 791 A1); US000006127243A (US 61 27 243 A); US000004962062A (US 49 62 062); JP000S63168054A (JP 63-1 68 054 A)

[43] **Erstveröffentlichungstag:** 10.07.2003

[-----] **Anzahl der Bescheide:** 2

[-----] **Anzahl der Erwiderungen:** 2

[-----] **Erstmalige Übernahme in DPMAregister:** 26.05.2011

[-----] **Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister:** 26.05.2011; 17.07.2011; 06.12.2011; 25.01.2012; 06.12.2012; 23.01.2013; 24.01.2013; 11.12.2013; 30.01.2014; 10.12.2014; 05.02.2015; 09.12.2015; 20.01.2016; 06.02.2016; 28.01.2017; 19.07.2018; 23.08.2018; 07.01.2024

Verfahrensdaten

Vorverfahren

[-----] **Verfahrensart:** Vorverfahren

[-----] **Verfahrensstand:** Die Anmeldung befindet sich in der Vorprüfung

[-----] **Verfahrensstandstag:** 16.11.2001

Prüfungsverfahren

[-----] **Verfahrensart:** Prüfungsverfahren

[-----] **Verfahrensstand:** Prüfungsantrag wirksam gestellt

[-----] **Verfahrensstandstag:** 16.11.2001

[-----] **Antrag Dritter:** Nein

[-----] **Eingangstag:** 16.11.2001

Klassifikationsänderung

[-----] **Verfahrensart:** Klassifikationsänderung

[-----] **Verfahrensstand:** Änderung der IPC-Hauptklasse

[-----] **Verfahrensstandstag:** 15.03.2002

[51] **IPC-Hauptklasse:** H01L 21/58 (2000.01)

[51] **Frühere IPC-Hauptklasse:** H01L 21/68 (2000.01)

Prüfungsverfahren

[-----] **Verfahrensart:** Prüfungsverfahren

[-----] **Verfahrensstand:** Erwiderung auf Prüfungsbescheid

[-----] **Verfahrensstandstag:** 19.08.2002

Vorverfahren

[-----] **Verfahrensart:** Vorverfahren

[-----] **Verfahrensstand:** Das Vorverfahren ist abgeschlossen

[-----] **Verfahrensstandstag:** 02.10.2002

Prüfungsverfahren

[-----] **Verfahrensart:** Prüfungsverfahren

[-----] **Verfahrensstand:** Erteilungsbeschluss durch Prüfungsstelle/Patentabteilung

[-----] **Verfahrensstandstag:** 28.02.2003

Publikationen

[-----] **Verfahrensart:** Publikationen

[-----] **Verfahrensstand:** Patentschrift

[-----] **Verfahrensstandstag:** 10.07.2003

[-----] **Heftnummer:** 28

[-----] **Jahr:** 2003

[-----] **Veröffentlichungsdatum:** 10.07.2003

[-----] **Publikationsart:** Schriften

[-----] **Teil:** Teil 3

[10] **Veröffentlichte DE-Dokumente:** DE000010156465C1

Prüfungsverfahren

[-----] **Verfahrensart:** Prüfungsverfahren

[-----] **Verfahrensstand:** Patent rechtskräftig erteilt

[-----] **Verfahrensstandstag:** 10.10.2003

[-----] **Heftnummer:** 3

[-----] **Jahr:** 2004

[-----] **Veröffentlichungsdatum:** 15.01.2004

[-----] **Publikationsart:** Bibliografiedaten

[-----] **Teil:** Teil 3

Klassifikationsänderung

[-----] **Verfahrensart:** Klassifikationsänderung

[-----] **Verfahrensstand:** Änderung der IPC-Hauptklasse

[-----] **Verfahrensstandstag:** 17.10.2005

[51] **IPC-Hauptklasse:** H01L 21/58 (2006.01)

[51] **Frühere IPC-Hauptklasse:** H01L 21/58 (2000.01)

Verwaltungsverfahren

[-----] **Verfahrensart:** Verwaltungsverfahren

[-----] **Verfahrensstand:** Die Anmeldung gilt als zurückgenommen wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr/das Schutzrecht ist wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen

[-----] **Verfahrensstandstag:** 02.06.2018

[-----] **Heftnummer:** 34

[-----] **Jahr:** 2018

[-----] **Veröffentlichungsdatum:** 23.08.2018

[-----] **Publikationsart:** Bibliografiedaten

[-----] **Teil:** Teil 3